

Dilase 250

Equipo de Escritura Directa por Láser de Sobremesa

- ▶ Sistema de sobremesa muy compacto
- ▶ Fabricación de máscaras y escritura directa
- ▶ Fuente láser de 375nm o 405nm
- ▶ Compatible con todas la fotoresinas
- ▶ Alta Relación de Aspecto: mínimo garantizado 1:20



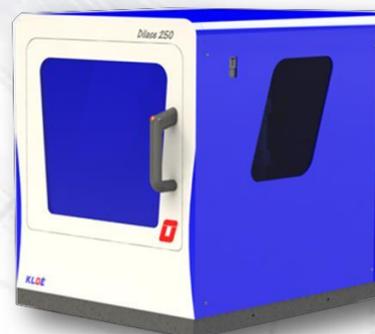
El **Dilase 250** es un práctico equipo de micro-litografía de sobremesa y de alta resolución. Gracias a su láser de 375 o 405 nm es posible usar la mayoría de las fotoresinas comerciales del mercado. El área de escritura máxima puede ser de 4" y los mínimos detalles que pueden ser escritos son de 1 μm .

Este equipo ofrece los modos de escritura vectorial y scanning y asegura una trayectoria dentro de una desviación máxima de 100 nm. Incluye un sistema motorizado para focalizar, permitiendo usar sustratos desde 150 μm a 5 mm. Gracias a la gran profundidad de foco, la calidad de escritura no se ve perjudicada por las irregularidades de la superficie o la falta de homogeneidad del sustrato.

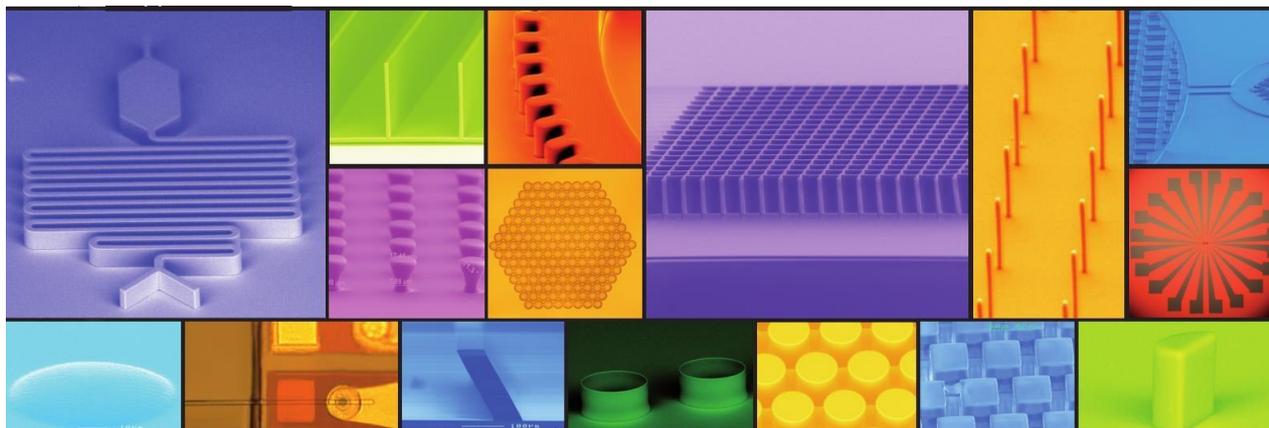
El sistema Dilase 250 es compatible con la mayoría de las fotorresinas comerciales que existen en el mercado, como pueden ser SU8, Shipley y resinas AZ. Para conseguir microestructuras de alta relación de aspecto, es aconsejable utilizar las resinas proporcionadas por KLOÉ debido a sus altas prestaciones mecánicas.

Especificaciones

- Dimensiones: 550 x 670 x 700 mm.
- PC completamente equipado.
- Láseres disponibles: 375 or 405 nm.
- Tubo óptico para la limpieza y tratamiento del haz láser.
- Configurable el tamaño del haz.
- Sistema de video-posicionamiento de alta resolución.
- Formato de datos admitidos: LWI, DXF y GDS2.
- Configuración de enfoque automático.
- Software de diseño integrado: Kloé Design V.2.
- Dos modos escritura: vectorial y scanning



Aplicaciones



Microfluidica – Microelectrónica- MEMS – Fotonica – Micromecánica – Estructuración Superficial...

Especificaciones Técnicas

Velocidad lineal de escritura	>100 mm/s
Resolución stage	100 nm
Repetibilidad	100 nm
Área de escritura	Obleas de hasta 4"
Grosor de sustrato	De 150 μ m a 50 mm
Diámetro del haz	De 1 μ m a 50 μ m
Factor de forma	Mínimo 10
Precisión de alineamiento multinivel	1 μ m